

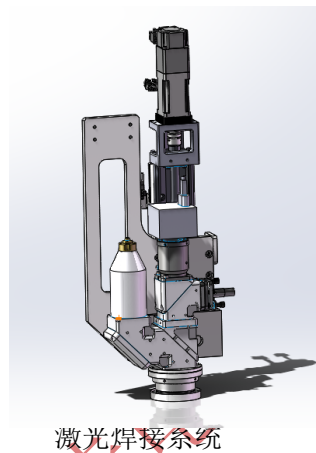


双工位激光锡膏焊锡机

ABT-1880

一、设备介绍

- 1、适用于锡膏焊接
- 2、采用双工位，焊接效率更高，一致性好。特别适合热效应敏类感器件加工。
- 3、激光，CCD，测温，指示光四点同轴。完美的解决了行业内多光路重合难题并避免复杂调试，CCD 摄像定位更精准
- 4、实时的温度 PID 算法反馈系统，可直接实时控制焊点的温度，并能实时呈现焊接温度曲线，保证焊接的良率。
- 5、半导体激光器热源，焊接过程无接触，热效应传导小。



激光焊接系统



点锡膏装置

二、技术参数

部件	参数	部件	参数
供电电源	AC220V±10V 频率: 50/60Hz	运动平台行程	X1X2*Y1Y2*Z1Z2 200*200*100mm
功耗	2KW	激光波长	915nm
激光器	半导体激光器	最小点锡膏直径	0.3mm
激光功率	80W	重复精度	0.01mm
光纤芯径	标配 400 μm	点锡尺寸最小	0.3mm
定位	CCD 同轴自动定位		

三、应用领域

- 1、主要适用各种大功率、大热熔、透锡填充率 100%器件、异型器件焊锡，微精密特殊零件、对飞溅残留有高要求的焊锡产品；
- 2、通讯、军工、航天、汽车电子、医疗器械，手机等。

四、应用实例

